

資通訊供應鏈產品晶片資安驗證制度_參照指引

資通訊供應鏈產品晶片資安驗證制度（以下簡稱本制度）已於114年8月5日由數位發展部數位產業署公告。為促進本制度之推動，特增『資通訊供應鏈產品晶片資安驗證制度_參照指引』說明。

資通訊供應鏈產品晶片資安驗證制度_參照指引

條文	說明
<p>1. 驗證制度概述</p> <p>1.1 制度目的</p> <p>「資通訊供應鏈產品晶片資安驗證制度」 (以下簡稱本制度)，係由數位發展部數位產業署(以下簡稱本署)訂定，旨在於建構一套具一致性與公信力的驗證機制，作為我國推動資通訊供應鏈產品晶片資安管理之核心依據，以強化整體供應鏈安全，並提升國內產業之國際競爭能力。</p> <p>1.2 適用範圍</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 本制度驗證標準如下 <ul style="list-style-type: none"> ■ SSIPS：台灣區電機電子工業同業公會發布之《資通訊產品供應鏈資安標準 第一部 晶片安全》、《資通訊產品供應鏈資安測試規範 第一部 晶片安全》 ■ SESIP：GlobalPlatform，《Security Evaluation Standard for IoT Platforms》 文件編號 GP_FST_070 (Public Release) ● 本制度執行遵循公正性與無歧視原則，認可驗證機構及認可實驗室之內部管理文件應體

條文	說明
<p>本制度適用於資通訊供應鏈中晶片產品、認可驗證機構、認可實驗室及申請者。</p>	<p>現公正性之說明。</p>
<p>2. 名詞解釋</p> <p>2.1 認證：係指由認證機構對驗證機構、測試實驗室所執行之正式資格評定程序，用以證明其具備執行驗證所需的能力。</p> <p>2.2 驗證：係指由認可驗證機構依據本制度，對晶片產品進行符合性評估、審查及驗證決定，並出具證明之程序。</p> <p>2.3 晶片產品：指由積體電路（Integrated Circuit, IC）所構成，並整合於資訊通信科技（ICT）產</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 無。

條文	說明
<p>品中，具備處理、儲存、控制或通信等功能之關鍵電子模組。晶片產品範圍涵蓋晶片層、系統層與軟體層，涵蓋硬體至軟體各層級，並可作為資訊產品整體資安評估與驗證之基礎單元。</p>	
<p>3. 驗證制度之管理</p> <p>3.1 驗證制度中角色及權責</p> <p>3.1.1 認證機構：本制度指的認證機構為財團法人全國認證基金會（Taiwan Accreditation Foundation，簡稱 TAF），負責認證驗證機構與實驗室能力。</p> <p>3.1.2 認可驗證機構：經本署同意負責執行驗證作</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 無。

條文	說明
<p>業之機構，可提供證明文件。</p> <p>3.1.3 認可實驗室：受理設計業者、製造商或終端設備製造商之申請，提供申請者進行資安測試服務之單位。</p> <p>3.1.4 申請者（證明文件擁有者）：係指晶片設計業者或晶片製造商，提供技術文件與樣品，應委託認可實驗室向認可驗證機構提出申請，通過後授於合格證明文件。</p>	
<p>3.2 認可驗證機構資格</p> <p>3.2.1 具備驗證及專業技術能力之合法實體機構，資格要求如下：</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 本章節中 3.2.1 第（2）點，資安評估項目至少需包含「驗證評估」相關資料。 ● 本章節 3.2.1 第（3）點，本項之 ISO/IEC

條文	說明
<p>(1). 通過 TAF ISO/IEC 17065 ; CNS 17065 產品驗證機構</p> <p>(2). 至少 1 案晶片資安評估或測試經驗</p> <p>(3). 通過 ISO/IEC 27001 ; CNS 27001 資訊安全管理系統</p> <p>3.2.2 經本署同意，並遵守此制度之管理要求。</p>	<p>27001 證書適用範圍應涵蓋機構執行晶片資安產品驗證之相關部門或業務。證書範圍如為全公司或部分部門，且晶片驗證業務位於其適用範圍內者，即視為符合本規定。</p>
<p>3.3 認可實驗室資格</p> <p>3.3.1 具備測試及專業技術能力之合法實體機構，並通過 TAF ISO/IEC 17025 ; CNS 17025 之測試實驗室。</p> <p>3.3.2 經認可驗證機構評核，並配合每年接受監督</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 本章節中 3.3.2 中所指「監督評鑑」為認可驗證機構向認可實驗室所執行之「技術能力考核」，其考核結果若為「暫時終止」或「撤銷」時應書面通報本制度主管機關。

條文	說明
<p>評鑑，並遵守此制度之管理要求。</p> <p>3.3.3 報告簽署人之要求：大學以上，曾受過晶片資安領域相關課程達 20 小時。</p>	
<p>3.4 認可驗證機構管理</p> <p>3.4.1 認可驗證機構經本署同意後，其執行期間為 3 年。期滿後將由本署依據 TAF 每年監督評鑑結果進行評估後決定續辦。</p> <p>3.4.2 認可驗證機構可執行本制度外之驗證方案，應確保能明辨執行驗證方案之不同，且不得有利益衝突或範圍模糊之情形。</p> <p>3.4.3 認可驗證機構接受 TAF 監督評鑑結果若為</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 本章節中 3.4.1 中監督評鑑權責單位得派人參與。 ● 本章節中備考之名詞定義可參照如下： <ul style="list-style-type: none"> 「終止」為符合一定條件下，正式結束有效的關係、驗證契約或資格，自終止日起雙方的權利與義務不再繼續。 「暫時終止」為使申請者所取得本制度中認證範圍的全部或一部分之資格於特定期限

條文	說明
<p>暫時終止或撤銷，應主動通知本署。</p> <p>3.4.4 認可驗證機構應具備符合本制度及認證機構評鑑監督之文件紀錄、資源及能力，當本署需要調閱時應即時提供，並指派符合此驗證制度資格之人員，與本署聯繫。</p> <p>3.4.5 認可驗證機構執行驗證應遵守本制度辦理，本署保留最終裁決權。</p> <p>3.4.6 驗證活動中產生之抱怨、申訴與糾紛處理及決議之過程，予以文件化紀錄，當本署要求時提供。</p> <p>3.4.7 審驗報告及過程紀錄係為機密文件且為申請</p>	<p>暫時停止的決定。</p> <p>「撤銷」為違反本制度中認驗證規定者，將使所取得本制度中認驗證範圍之資格及溯及既往喪失的決定。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本章節中 3.4.7 驗證活動中之報告及過程紀錄係為機密文件，其調閱權為驗證申請者、認可實驗室、認可驗證機構、認證機構及本署於本制度各活動階段及其目的使用，或經前述各相關單位之書面同意之其他單位或人員。

條文	說明
<p>者所有。僅限提供給認可驗證機構及本署， 或經申請者書面同意之其它單位或人員。</p> <p>3.4.8 認可驗證機構取得本署同意後，若無法履行 本制度者，本署得逕行必要之處置，並停止 與認可驗證機構之合作，本署之處置包括終 止、暫時終止、撤銷。</p> <p>備考：認證處置為終止、暫時終止、撤銷， 依循「產品驗證機構認證方案服務手冊 (TAF-PC-M01)」。</p>	
<p>3.5 驗證制度之制定或修訂</p> <p>3.5.1 本署對此驗證制度保有最終解釋權。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 無。

條文	說明
<p>3.5.2 制定或修訂草案核准至實施之期間，視為緩衝期，認可驗證機構應於此期間針對變動內容進行因應，並就受影響範圍作出評估與調整。</p> <p>3.5.3 緩衝期之長度應視其變動內容與性質範圍而定，至少 6 個月不等。認可驗證機構應於修正或改版公告後 20 個工作日內，主動通知其認可實驗室最新驗證之驗證制度資訊。</p>	
<p>3.6 認可驗證機構之人力資源要求</p> <p>3.6.1 認可驗證機構應具備人力、資源以滿足驗證活動，其成員皆須為機構正式人員。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 本章節中 3.6.1 中機構人力係指評估人員、審查人員及驗證決定者之設置。 ● 本章節中 3.6.3 中審查之專業人員係包含「驗

條文	說明
<p>3.6.2 對測試報告執行評估之專業人員應大學以上，曾受過晶片資安領域相關課程達 20 小時以上，且具晶片資安領域相關工作 1 年以上經驗。</p> <p>3.6.3 對評估報告執行審查之專業人員應大學以上，曾受過晶片資安領域相關課程達 40 小時以上，且具晶片資安領域相關工作 3 年以上經驗。</p> <p>3.6.4 認可驗證機構應提供執行驗證活動之人員名單，並保存與更新其參與驗證活動過程中所有紀錄。</p>	<p>證決定者」之資格條件，其審驗報告執行驗證決定之專業人員應大學以上，曾受過晶片資安領域相關課程達 40 小時以上，且具晶片資安領域相關工作 3 年以上經驗。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本章節中 3.6.6 中「人員培訓」之初始資格訓練，應由具晶片安全相關實務經驗之師資或機構授課。

條文	說明
<p>3.6.5 認可驗證機構應每年依驗證方案之規範文件及規範性參考文件，向機構人員進行至少 6 小時培訓，並制定培訓結果的評估流程。</p> <p>3.6.6 認可驗證機構應有人員培訓及績效查核流程，包含新進評估人員成為正式評估人員之晉用，應有參與實際案例之考核過程。</p> <p>3.6.7 新進評估人員成為正式評估人員前，應由認可驗證機構的正式評估人員協助及指導，完整參與驗證活動中的評估執行，並留下培訓紀錄。</p>	
<p>4. 驗證制度之驗證流程</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 本章節中有關申請、受理（初次）可由認可

條文	說明
<p>4.1 申請、受理（初次、變更、展延）</p> <p>4.1.1 欲申請驗證（含初次、變更、展延）之申請者，應備妥申請文件，透過認可實驗室遞交申請。</p> <p>4.1.2 申請者應檢附文件</p> <ol style="list-style-type: none"> (1). 營利事業登記證或等同文件 (2). 產品使用說明/手冊/指引 (3). 產品規格書 (4). 符合聲明書 (5). 認可實驗室所核發之晶片產品試驗報告 <p>4.1.3 禁止任何申請者在未經合法授權的情況下，</p>	<p>驗證機構製作相關書面表單資料供辦理。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本章節中 4.1.4、4.1.6 中所指「2 個月」內，依實務採以「60 工作天」計算。

條文	說明
<p>代表他人公司提出產品驗證申請。</p> <p>4.1.4 認可驗證機構受理申請者所提交之相關文件並進行初步審核，經受理後計收驗證費用。資料不完整者應於 2 個月內完成補件，未於期限內提交，視同結束申請。</p> <p>4.1.5 申請變更應檢附差異說明、必要之技術資料或其他經認可驗證機構指定之應檢附文件。資料不完整者應於 2 個月內完成補件，未於期限內提交，視同結束變更申請。</p> <p>4.1.6 申請展延應檢附未變更之聲明、必要之技術資料，或其他經認可驗證機構指定之應檢附</p>	

條文	說明
<p>文件。資料不完整者應於 2 個月內完成補件，未於期限內提交，視同結束展延申請。</p>	
<p>4.2 評估、審查及驗證決定</p> <p>4.2.1 認可驗證機構依據本制度，指派條件符合 3.6 之人員執行評估、審查作業。</p> <p>4.2.2 申請資通訊供應鏈產品資安驗證之產品，經審查核可後，由認可驗證機構核發證明文件，經由認可實驗室遞交予申請者。</p> <p>4.2.3 評估及審查後經驗證決定且符合，應通知申請者並核發證明文件。若不符合，由認可驗證機構以書面形式告知申請者，申請者應於</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 無

條文	說明
<p>收到通知後 3 個月內完成改善，逾期即視為案件終止應重新提出申請。</p> <p>4.2.4 證明文件有效期為 3 年，應依認可驗證機構每年排定執行後市場監督管理持續確保其有效性。</p>	
<p>4.3 變更及展延</p> <p>4.3.1 認可驗證機構受理證明文件擁有者辦理變更及展延，認可驗證機構應制定程序執行並符合本制度要求。</p> <p>4.3.2 當驗證前提條件變更或發現新事證影響判定正確性時，認可驗證機構應調整先前之驗證</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 本章節中有關申請、受理（變更及展延）之申請可由認可驗證機構製作相關書面表單資料供辦理。 ● 本章節 4.3.4、4.3.5 中之「資安功能」，係指技術方法變更等。 ● 本章節 4.3.5 中係說明「實現資安功能之技術

條文	說明
<p>決定，或對原驗證決定進行修正或撤銷。</p> <p>4.3.3 已取得驗證證明文件之晶片產品有變更情事時，無論性質為何，應由申請者主動通知認可實驗室及認可驗證機構，並向認可驗證機構提出變更申請。</p> <p>4.3.4 產品申請變更如未涉及資安功能時，且由認可驗證機構核實無誤後，得據以辦理證明文件之變動。</p> <p>4.3.5 產品申請變更如涉及資安功能時，應由認可驗證機構評估其對原驗證決定之影響。若影響重大（如：用來實現資安功能之技術方法</p>	<p>方法改變等情況」如：核心功能、CPU 架構、SoC 或安全模組設計。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本章節 4.3.9 中「原證明文件」指首次核發之有效證書。

條文	說明
<p>改變等情況)，須經認可實驗室補充測試，查證不影響原申請資安功能，得據以辦理證明文件之變動。若影響輕微（如：未影響原申請資安功能等情況），得由認可驗證機構依評估結果決定是否接受並辦理證明文件變更。</p> <p>4.3.6 申請者應於文件有效期間屆滿前 6 個月，透過認可實驗室向認可驗證機構提出展延申請，期限屆滿前未申請展延證明文件不得繼續使用，於證明文件有效日期屆滿前 10 個月應由認可驗證機構主動通知申請者辦理展</p>	

條文	說明
<p>延，若未於前述期限內通知，相關情況由認可驗證機構依個案酌情處理。</p> <p>4.3.7 若未於規定期限內申請者，則應重新辦理產品驗證。</p> <p>4.3.8 申請展延之產品不得有任何外觀、軟體、硬體之變更，且由認可驗證機構核實並決定其對驗證結果之影響，始得續用原驗證結果或依本制度文件第 4.3.1 要求辦理變更，必要時認可驗證機構可至現場訪查或要求申請者送樣，申請者不得拒絕。</p> <p>4.3.9 展延申請經認可驗證機構核可者，得展延原</p>	

條文	說明
證明文件有效期間 1 次。	
<p>4.4 終止、暫時終止</p> <p>4.4.1 申請者使用違法或不當之方式通過驗證，經認可驗證機構查實後，將暫時終止、終止驗證。</p> <p>4.4.2 申請者於取得證明文件後，如因不當使用致使本署權益受損或有損機構信譽之虞者，發現者應通報認可驗證機構，由認可驗證機構視情節輕重，決定採取終止、暫時終止驗證。</p> <p>備考：終止驗證及暫時終止之處置措施依循</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 本 4.4 章節「終止」係指為「終止驗證」 ● 本 4.4.1 章節中「不當之方式」係包含驗證前提條件變更或發現新事證影響判定正確性時，認可驗證機構應調整先前之驗證決定所核發之證明文件，或對原驗證決定進行修正或撤銷。 ● 本章節中備考之名詞定義可參照如下： 「終止驗證」：認證範圍的資格全部喪失，不得再繼續使用認證標誌或以任何方式宣稱擁有該項認證資格。

條文	說明
<p>全國認證基金會「產品驗證機構處置方案」 (TAF-PC-01) 所述。</p>	<p>「暫時終止」：申請驗證的申請者違反驗證規範，須改善得再行回復其相關權利。</p>
<p>5. 後市場監督管理</p> <p>5.1 認可驗證機構應每年實施產品後市場監督管理，申請者不得無故規避、妨礙或拒絕。</p> <p>5.2 申請者應提供目前儲放於倉庫之產品序號清單，供認可驗證機構進行隨機抽樣。認可驗證機構得視需要執行抽樣管理，並依照實際抽樣調整抽樣方式、對象或頻次，以執行再評估與審查作業。</p> <p>5.3 於後市場監督管理中進行再評估之產品，其外</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 本章節 5.2 中後市場監督管理的執行原則，由認可驗證機構公開之書面表單資料供辦理。 ● 本章節 5.3 中再評估之產品之軟、硬體規格執行功能查驗，由認可驗證機構公開之書面表單資料供辦理，測試與審查標準比照初次驗證。

條文	說明
<p>觀、軟體、硬體規格應與證明文件所載內容一致，否則視為不符合。</p> <p>5.4 為維護驗證制度之有效性，倘當年度監督活動中發現不符合事項，認可驗證機構得視情節增列次年度監督頻次，或撤銷相關驗證範圍之項目。</p> <p>5.5 後市場監督結果為不符合，得暫時終止或終止驗證、撤銷申請者驗證資格及證明文件。</p> <p>5.6 展延產品之後市場監督管理驗證週期原則為 3 年內至少執行一次。</p>	